

2016

Technology Seminar

TRI innovation

Inspection and Testing for Industry 4.0

迎接工業4.0的到來

日期..... 時間.....

31 MAR 9:00AM
2016 16:00PM

地點.....

TRI Production Center Linkou

TRI 林口生產中心

時程

9:20~9:40	報到 報名與早餐
10:00~10:10	開場 林副總 開場及前言
10:10~10:50	3D SPI 高速及自動化3D SPI
10:50~11:40	3D AOI 超精準3D 爬錫與焊點檢測
11:40~12:00	產品展示 現場產品展示
12:00~13:30	午餐 用餐及交流
13:30~14:20	AXI, CT 檢測 革命性斷層掃描(CT)應用與 NPI Solutions
14:20~15:00	Multi-core ICT Testing 新型多核心TR5001 SII 系列 ICT
15:00~15:30	YMS 4.0 生產良率管理系統
15:30~16:00	茶點+產品展示
16:00	Q&A, 有獎徵答

新產品介紹



TR7007Q 3D SPI

智能型走停式3D SPI,擁有四向數位條紋光投影,最高解析度可達6 μ m,適合0250125 mm微小元件檢測。



TR7700Q 3D AOI

精準型走停式3D AOI,擁有四向數位條紋光投影,最高解析度可達6 μ m,可檢測錫點的爬錫品質及高度。



TR7600F3D AXI

全新3D X射線檢測系統擁有平板式相機及超高解析的斷層數位掃描(CT),可檢測複雜的多層板及隱藏式錫點。



TR5001 SII 系列 ICT

新型多核心及平行測試的ICT檢測方案,提升檢測精準度、速度、產能及減低人力需求。

若有任何問題請連絡:

Susan Hsu 小姐 Tel: +886-2-2832-8918 分機 2585 或 email: Susan_Hsu@tri.com.tw

<http://marketing.tri.com.tw/2016seminar/tw.aspx>

誠邀參加!

線上報名請按此

德律® TRI INNOVATION®

